

中華民國專利公報 (19)(12)

(11)公告編號: 299338

(44)中華民國86年(1997)03月01日

發明

全 2 頁

(51)Int. Cl. 6: C08G69/02

(54)名稱: 聚醯胺及聚醯胺組成物

(21)申請案號: 83111536

(22)申請日期: 中華民國83年(1994)12月12日

(72)發明人:

岡秀明

柏村次史

橫田伸一

林原廣

日本

日本

日本

日本

(71)申請人:

可樂麗股份有限公司

日本

(74)代理人: 陳燦暉 先生 洪武雄 先生

第93137877號初審引證附件

1

2

[57]申請專利範圍:

1. 一種聚醯胺, 包括一種二羧酸成分(a)包括60至100莫耳%之對酞酸之二羧酸成分, 及一種二胺成分(b)包括60至100莫耳%之1,9-壬二胺之二胺成分, 該聚醯胺具有於30℃之濃硫酸中測得之特性黏度[η]為0.6至2.0 dl/g, 且有至少10%端基被封阻等特性。
2. 如申請專利範圍第1項之聚醯胺, 其中該二胺成分之60至100莫耳%包括1,9-壬二胺及2-甲基-1,8-辛二胺, 1,9-壬二胺與2-甲基-1,8-辛二胺間之莫耳比係在60:40至99:1之範圍者。
3. 如申請專利範圍第1或2項之聚醯胺, 其中至少有70%端基被封阻者。
4. 一種聚醯胺, 包括一種二羧酸成分(a)包括60至100莫耳%之對酞酸之二羧酸成分, 及一種二胺成分(b)包括

5. 60至100莫耳%之1,9-壬二胺及2-甲基-1,8-辛二胺之二胺成分, 1,9-壬二胺與2-甲基-1,8-辛二胺之莫耳比係在60:40至99:1之範圍, 該聚醯胺具有於30℃之濃硫酸中測得之特性黏度[η]為0.4至3.0dl/g之特性。
5. 如申請專利範圍第4項之聚醯胺, 具有於30℃之濃硫酸中測得之特性黏度[η]為0.6至2.0dl/g之特性。
10. 6. 如申請專利範圍第4或5項之聚醯胺, 其中至少有10%端基被封阻者。
7. 如申請專利範圍第4或5項之聚醯胺, 其中至少有40%端基被封阻者。
15. 8. 如申請專利範圍第4或5項之聚醯胺, 其中至少有70%端基被封阻者。
9. 一種聚醯胺組成物, 包括100份重量比之如申請專利範圍第1項至第8項中任一項之聚醯胺, 及0.1至200份重量比之填充劑。

(2)

3

- 10.如申請專利範圍第9項之聚醯胺組成物，其中該填充劑為具有平均顆粒直徑由 0.1μ 至 200μ 之微粒狀填充劑。
- 11.如申請專利範圍第10項之聚醯胺組成物，其中該填充劑係選自氧化矽、氧化矽—氧化鋁、氧化鋁、氧化鈦、氧化鋅、氧化硼、滑石、雲母、鈦酸鉀、矽酸鈣、硫酸鎂、硼酸鋁、矽藻土、玻璃珠、碳黑、石墨、二硫化鋁及

4

聚四氟乙烯。

- 12.如申請專利範圍第9項之聚醯胺組成物，其中該填充劑為具有平均長度由 0.05 至 50mm 之纖維狀填充劑。
5. 13.如申請專利範圍第12項之聚醯胺組成物，其中該纖維狀填充劑係選自玻璃纖維、全芳香系聚醯胺纖維、全芳香系液晶聚酯纖維、碳纖維及硼纖維。